



kingston.com/epop

ePoP

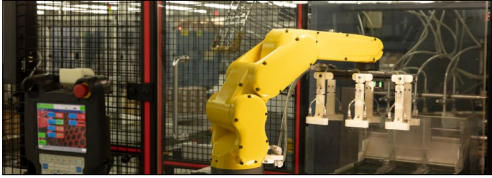
ePoP – Memoria Paquete sobre paquete integrada para ponibles

ePoP de Kingston es un componente compatible con JEDEC altamente integrado que combina un almacenamiento con tarjeta multimedia integrada (MMC) con un módulo DRAM de doble velocidad de datos y bajo consumo (LPDDR) dentro de una solución PoP (Paquete sobre paquete). ePoP se monta directamente en un Sistema en un chip (SoC) anfitrión compatible, con lo cual se reduce el espacio de la placa de circuitos impresos (PCB) y se garantiza un rendimiento óptimo. ePoP es una solución ideal para aplicaciones de espacio restringido, como los ponibles.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Al ir montado directamente sobre un SoC anfitrión, ePoP es una solución ideal para aplicaciones de pequeño factor de forma, como los ponibles.
- La DRAM de bajo consumo y el firmware de almacenamiento optimizado consume menos electricidad, mientras que ofrece el alto rendimiento necesario para aplicaciones ponibles alimentadas por batería.
- Simplifica el diseño del sistema, reduce el plazo de lanzamiento al mercado y acorta el ciclo de homologación.
- Disponibilidad de múltiples configuraciones de firmware a la medida de los requisitos de rendimiento, alimentación y vida útil de su aplicación.

SEGMENTOS DE MERCADO



IdC



Ponibles



Dispositivos de realidad aumentada (AR) / realidad virtual (VR)

NÚMEROS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES DE EPOP

ePoP basado en LPDDR3

Número de referencia	Capacidad		Estándar		Paquete	FBGA	Temperatura de servicio
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM	(mm)		
04EP04-N3GM627	4	4	5,0	LPDDR3	10 x 10 x 0,8	136	-25°C ~ +85°C
04EP08-N3GM627	4	8	5,0	LPDDR3	10 x 10 x 0,85	136	-25°C ~ +85°C
08EP08-N3GTC32*	8	8	5,1	LPDDR3	10 x 10 x 0,85	136	-25°C ~ +85°C
32EP08-N3GTC32	32	8	5,1	LPDDR3	10 x 10 x 0,85	136	-25°C ~ +85°C

ePoP basado en LPDDR4x

Número de referencia	Capacidad		Estándar		Paquete	FBGA	Temperatura de servicio
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM	(mm)		
08EP08-M4ETC32*	8	8	5,1	LPDDR4x	8 x 9,5 x 0,8	144	-25°C ~ +85°C
08CP08-M4ETC32*	8	8	5,1	LPDDR4x	8 x 9,5 x 0,85	144	-25°C ~ +85°C
16EP08-M4ETC32	16	8	5,1	LPDDR4x	8 x 9,5 x 0,8	144	-25°C ~ +85°C
32EP08-M4ETC32	32	8	5,1	LPDDR4x	8 x 9,5 x 0,8	144	-25°C ~ +85°C
16EP16-M4FTC32	16	16	5,1	LPDDR4x	8 x 9,5 x 0,8	144	-25°C ~ +85°C
32EP16-M4FTC32	32	16	5,1	LPDDR4x	8 x 9,5 x 0,8	144	-25°C ~ +85°C
32CP16-M4FTC32	32	16	5,1	LPDDR4x	8 x 9,5 x 0,85	144	-25°C ~ +85°C

*Modo pSLC para una mayor resistencia